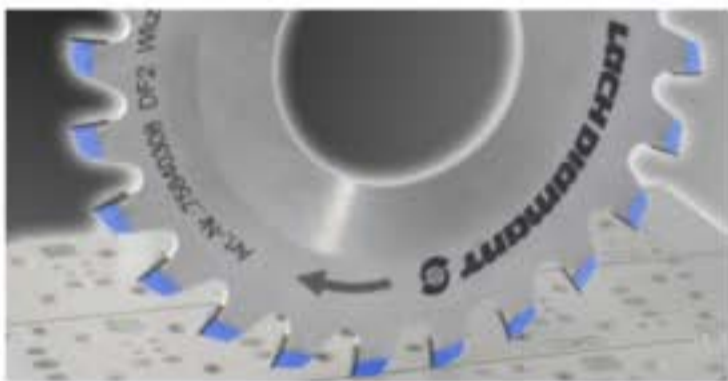


TOOLING

PCB-LEITERPLATTEN TRENNEN – RITZEN – FRÄSEN MIT ÜBERLEGENEN DIAMANT- UND VHM-WERKZEUGEN

© OCTOBER 31, 2019 ▲ PIERRE-YVES SCHMID ● LEAVE A COMMENT

Erstmals von Lach Diamant auf der *productronica* 1977 vorgeführt, können sich Besucher der diesjährigen *productronica* überzeugen, was Lach Diamant für die weltweit führenden Elektronik-Hersteller heute an überlegenem Diamant- und Hartmetall-Werkzeug für wirtschaftliche Leiterplattenfertigung bereithält.



Beispiel: „Nutzentrenner“ für stressfreie Leiterplatten-Trennung im Mehrfachnutzen mit höchster Präzision; Schnittbreiten ab 0,3mm werden realisiert. Verzahnte Werkzeuge sind mit einer ultrafeinen Zahnteilung bis zu 1,4mm lieferbar.

Ritzwerkzeuge: Waren es anfangs einlagige Platten, die mit VHM Ritzwerkzeugen problemlos bearbeitet werden konnten, ist die Entwicklung längst weitergegangen.

Mittlerweile kommen Glasfaser, Keramiken und Hybridwerkstoffe zum Einsatz; Lach Diamant entwickelte hierfür dank neuer Fertigungstechnologien die Standzeit überlegenen PKD-Hochleistungs-Ritzer »DreboBlueCut«.

Alle Ritzer sind wie bei Lach Diamant üblich, in allen Spezialausführungen und Schneiden Geometrien ab Lager oder kurzfristig lieferbar.

Hybridwerkstoffe und weitere Herausforderungen: Lach Diamant als Global Player in der Werkzeugbranche – gegründet 1922 – entwickelt und fertigt, seit der ersten Präsentation 1977 auf der *productronica*, für alle weltweit führenden Elektronikhersteller die für eine wirtschaftliche Fertigung unerlässlichen Bearbeitungswerkzeuge.

So ist Lach Diamant auch für die neuen Herausforderungen gerüstet – beispielsweise für die derzeit mit den unterschiedlichsten Eigenschaften entwickelten Hybridwerkstoffe – mit elektrisch leitenden, hitzebeständigen – jedoch auch isolierenden und wärmeableitenden Eigenschaften usw.

Sprechen Sie mit Lach Diamant – ein Besuch auf dem Messestand B3.340 lohnt sich.

www.lach-diamant.de